Colegio Pío IX Taller de Radio Armado Realizado por Gerardo S. Rodríguez (gerardonet98.yahoo.com)

Diseño de circuitos impresos por computadora

EAGLE 3.55

Para Windows 95/NT

Introducción

El programa posee un panel de control a partir del cual se puede generar o editar: Un circuito teórico (archivos .sch) Un circuito impreso (archivos .pcb) Una librería de componentes (archivos .lbr) De esta manera el programa permite dibujar circuitos y generar cada una de las caras de un circuito impreso como así también plantilla de perforaciones y máscaras de soldadura. El programa provee una amplia gama de librerías de componentes, conectores, sensores, etc. y permite la generación de nuevas librerías y la edición de las librerías existentes. La versión de prueba del programa que está disponible en forma gratuita en internet (www.cadsoft.com) tiene las siguientes limitaciones:

- Tamaño máximo de plaqueta : 100 x 80mm.
- Cantidad de caras de circuito impreso disponibles : 2 (bottom y top)

Circuitos teóricos (Schematics)

Desde el panel de control se accede al módulo del programa que permite la edición de circuitos con la simbología utilizada normalmente en electrónica.



Para ello en "file" de la barra de comando seleccionar "new" o "open" (si se desea abrir un archivo ya existente) y luego "schematic".



Para incluir un componente en el dibujo se deberá previamente abrir una librería. Para esto se puede utilizar el ícono presente en la barra superior (función "**USE**").



Si en componente necesario no se encuentra en ninguna librería habrá que editarlo y generar una nueva librería (Ver apartado de "Creación y edición de una librería").

El programa trabaja con una grilla que le permite obtener fácilmente íneas rectas simetrías en los dibujos. Para editar esta grilla el ícono correspondiente es:



y permitirá hacer que la misma sea visible o no, modificar el tamaño de su trama, que sea representada por líneas o por puntos y finalmente elegir la unidad de medida.

Para realizar el coneccionado de los componentes se utiliza la barra de tareas y las opciones de visualización:

- **DISPLAY**: Permite seleccionar las capas de diseño (layers) que se desean aparezcan visibles en el diseño en curso. Cabe aclarar que en el momento e la impresión solo se imprimirán los elementos visibles en pantalla.
- MARK: Permite elegir el origen de coordenadas para la presentación de posición relativa indicada en la parte superior de la pantalla.



- **ADD**: con esta función se puede agregan al dibujo los componentes que incluye la librería previamente abierta.
- **NAME**: Permite modificar el nombre que el programa le asignó a los componentes y cables utilizados.
- VALUE: permite modificar el valor de un componente. Cabe aclarar que el valor asignado a un componente solo tiene sentido para la *pesentación* del circuito teórico ya que el circuito impreso no sufre modificación alguna y el programa no simula el funcionamiento del circuito.
- GROUP: activando esta función se podrá encerrar con un cuadro un conjunto de componentes formando con ellos un grupo que podrá ser editado en conjunto con las funciones CUT, PASTE, MOVE, DELETE, etc. mediante el botón derecho del mouse, mientras que con el izquierdo se editan los componentes por separado.
- CUT y PASTE: con CUT se puede cargar en el clipboard un componente o grupo y PASTE permite recuperarlo y pegar dicho objeto en el área de trabajo. A diferencia de otros programas que funcionan en entorno Windows, al aplicar la función CUT los objetos no se eliminan del área de trabajo.
- MOVE: permite desplazar un componente, cable o grupo seleccionado con el botón izquierdo del mouse en el área de trabajo. Con ésta función activa, con el botón derecho del mouse se puede rotar el objeto 90°, 180°, 270° y 360° (lo cual también puede hacerse con la función "ROTATE").
- MIRROW: genera la imagen especular de objetos y grupos respecto del eje Y.
- DELETE: permite eliminar un componente, cable o grupo del área de trabajo.
- ERC: ésta es una herramienta que realiza una verificación eléctrica del circuito. El programa corrobora que no halla terminales de componentes discretos o pines de entrada de integrados sin conexión o pines de salida utilizados como de entrada (con una tensión forzada por ejemplo).
- **TEXT**: permite agregar etiquetas de texto a un elemento o diseño.

Diseño de circuitos impresos (PCB)

Existen 2 formas diferentes de generar un circuito impreso:

- 1. Desde el panel de control. Para ello en "file" de la barra de comando seleccionar "new" o "open" (si se desea abrir un archivo ya existente) y luego "board".
- 2. A partir del circuito teórico con el ícono:



ubicado en la parte superior del módulo antes visto. Al pulsarlo se abrirá el módulo del programa para la generación de circuitos impresos con un recuadro blanco (que es el área de trabajo de 10cm. x 8 cm.) y a un lado el mismo los componentes utilizados en el teórico (con su encapsulado correspondiente) y con finas líneas amarillas las conexiones entre ellos. Es necesario llevar los componentes al interior de dicha área de trabajo pues fuera de ella el programa en su versión "light" no ejecuta ninguna función.

Cuando se inicia el diseño del circuito impreso a partir del teórico, el programa no permite la inclusión de nuevos componentes ni conexiones que no figuren en el teórico, para mantener la correspondencia entre ellos. Además interconecta automáticamente entre sí los pines de alimentación de los integrados de la misma familia.

Más allá de estas diferencias, el resto del diseño es el mismo para el caso 1. que para el caso 2.



Mediante el siguiente ícono:



se puede acceder al módulo de edición de circuitos teóricos (schematics), pero el programa no genera el circuito teórico a partir del impreso.

Las funciones USE, DISPLAY, MARK, MOVE, MIRROW, ROTATE, CUT, PASTE, DELETE, ADD, NAME, VALUE, SPLIT, WIRE y TEXT como así también las que sirven para dibujar figuras geométricas como CIRCLE, ARC, RECTANGLE y POLYGON, son las mismas que en el módulo de circuitos teóricos.

Veremos entonces algunas funciones propias de éste módulo.

| Info | 1 | Show | WIDE, parmita dibujar lípaga. La función sa trabaja |
|-----------|--------------------------------------|----------|--|
| Display | | Mark | igual que en el módulo de circuitos teóricos con la particularidad que éstas líneas serán pistas en las |
| Move | ↔ <u>₹</u> ₹ ₹ | Сору | caras (layers) llamadas "top" (lado componentes) y |
| Mirror | E3 P | Rotate | "bottom" (lado de abajo o lado cobre para plaquetas |
| Group | | Change | simple faz). |
| Cut | * > | Paste | componentes (pads). Estas conexiones deberán ser |
| Delete | | Add | luego ruteadas manualmente (ROUTE) o en forma |
| Name | | Value | automática (AUTO). |
| Smash | ı. | • | conexión (SIGNAL) va prestablecida. Al activar ésta |
| Pinswap | \$‡} 0+0 | Replace | función se incorpora en la parte superior de la pantalla |
| Split | 14 | Optimize | un menú que permite elegir la cara (top o bottom), el |
| Route | N | Ripup | tormato de la línea, espesor y los parámetros |
| Wire | | Text | desee trasladar una pista desde una cara a la otra de la plagueta. |
| Circle | <u>o</u> | Arc | RIPUP : Permite convertir una pista en una conexión |
| Rectangle | | Polygon | no ruteada (SIGNAL). |
| Via | | Signal | VIA: Permite insertar una isla. Al activar ésta función |
| Hole | | | menú que permite elegir la forma de la isla, el |
| Ratsnest | X | Auto | diámetro de la misma y el diámetro de la perforación correspondiente (DRILL) |
| ERC | | DRC | |
| Errors | <u>•</u> | | |

- HOLE: Genera una perforación en la plaqueta para, por ejemplo, la sujeción de la misma dentro de un gabinete. Al activar ésta función se incorpora en la parte superior de la pantalla un menú que permite elegir el diámetro de dicha perforación.
- CHANGE: si bien esta función también existe en el módulo anterior, aquí es donde tiene mayor • aplicación. Sirve para modificar todos los parámetros de los objetos ya dibujados.
- **REPLACE**: se utiliza para cambiar el encapsulado a un componente por otro de la misma • librería. Se mantiene el conexionado prestablecido.

NOTA: Al insertar un componente, una isla, pista, agujero, etc. los elementos guedan dibujados en las caras correspondientes (layers) de forma tal que si se desea por ejemplo imprimir solo los componentes esto se pueda hacer dejando visible sólo la cara (layer) correspondiente.

RATSNETS: Esta función calcula la mínima distancia entre los puntos a conectar indicados con SIGNAL.

 DCR: Esta es una herramienta que permite verificar si se cruzaron pistas en el dibujo (overlap) y además si se respetaron normas de diseño establecidas en un menú que aparece al activar la función.

| Design Rule Che | ck. | × |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| Checks | nin | max |
| P Dil | 0.6096 | 6.4770 |
| 🔽 Width | 0.2540 | 6.4770 condiciones o |
| Diameter | 1.0160 | 6.4770 normas de diseño |
| Distance | 0.2032 | |
| Pad Pad | 0.2032 | |
| 🔽 Smd | 0.2540 | |
| I Overlap | | |
| Angle | MaxEnors: | 50 Max. cantidad de |
| C OlfGrid | Signat | errores a analizar |
| Clear | Select | Errors |
| ОК | Cancel | Help |

- **ERRORS**: indica la lista de errores calculados con DRC y mediante una flecha muestra la ubicación de los mismos.
- AUTO: esta función realiza en forma automática el ruteo de las conexiones (signals) ya prestablecidas. Al hacer click en el ícono correspondiente se activa un menú que permite determinar distintos parámetros o condicionamientos para éste ruteo.

| Autorouter Setup | | | | × |
|--|-----------------------|---|--------------------|---------|
| Layer | Costs | - Maximum | - Minimum Distance | ; |
| 1 Тор 🗓 🛛 | Via 8 | Vias 20 | Wire | Via |
| | NonPref Para de mínin | eterminar las distancias nas entre los distintos | Wire 0.00800 | |
| | ChangeD of | ojetos del impreso | Pad 0.00800 | 0.00800 |
| | OrthStep 2 | RipupLevel II | Via 0.00800 | 0.00800 |
| • $0 = $ No rutear en esa ca | ara. | RipupSteps 1 | Dim 0.04000 | 0.04000 |
| *=Rutear en esa cara, | sin restricciones. | RipupTotal 100 | Restr 0.00800 | 0.00800 |
| = El ruteo en esa cará preferentemente horiza | ontal. | | | |
| I = El ruteo en esa can preferentemente vertis | a debe ser | -Pass | - Track | |
| • $/ o \setminus = El ruteo en esa d$ | cara debe ser | 🔿 Busses 🛛 💌 | Grid 🔽 | 0.05000 |
| preferentemente diago | nal | Route | Wire Width 🛛 🖸 | 0.01600 |
| | BusImpact 0 | 🖸 Optimize1 🛛 🔽 | Via Diameter 🛛 🖸 | 0.04000 |
| | Hugging | Para determinar los | Via Drill 🛛 🖸 | 0.02400 |
| | Avoid par | ámetros de los objetos | Via Shape 🛛 🛛 | Round 💌 |
| | Continue e | que va a generar el autorruteo | | |
| 7 | | | | |
| 16 Bottom - 0 | Create Job | Select Start | Cancel | Help |
| | | | | |

<u>NOTA</u>: Es importe darle a los componentes la mejor ubicación posible tal que sea simple el ruteo de las pistas debido a que puede ocurrir que el programa no encuentre como rutear determinadas conexiones con lo que el autorruteo será solo parcial.

Creación y edición de una librería.

Desde el panel de control se puede acceder a un módulo especial del programa que permite la edición o la creación de una nueva librería de componentes. En "file" de la barra de comando seleccionar "new" o "open" (si se desea abrir un archivo ya existente) y luego "library". Para generar un nuevo componente hay que definir 3 cosas:

- El símbolo (symbol) correspondiente al circuito teórico.
- El encapsulado (package) y sus islas (PADS) correspondientes al circuito práctico (circuito impreso).
- El dispositivo (device), es decir, la asignación de un encapsulado a determinados símbolos y la correspondencia entre los terminales de los símbolos y los " pads" del encapsulado.

Así, al acceder al módulo de librería en la barra superior aparecerán 3 íconos que permitirán editar cada una partes antes mencionadas.



Al hacer click sobre cualquiera de éstos íconos se abrirá un menú que permitirá elegir componentes de la librería abierta o generar un nuevo componente con la opción "new".

Cuando se accede a la edición del símbolo aparecerán del lado izquierdo de la pantalla una serie de íconos (cuyas funciones ya fueron mencionadas en otros módulos) que permitirán dibujar el símbolo del componente que de desea aparezca en el circuito teórico. A estos íconos se le agrega al final uno llamado " PIN" que permite indicar en el dibujo cuáles son los terminales de conexión del dispositivo. Al activar ésta función aparecerá en la parte superior el siguiente menú:



Para que el nombre y valor del símbolo sean visibles en el plano teórico, con la función "TEXT" se escribe ">NAME" en la cara (layer) 95 (names) y ">VALUE" en la cara 96 (values). De esta manera, cuando se esté editando un circuito teórico se podrán modificar dichos parámetros con las funciones ya explicadas.

Cuando se accede a la edición del encapsulado aparecerán del lado izquierdo de la pantalla una serie de íconos (cuyas funciones ya fueron mencionadas en otros módulos) que permitirán dibujar el componente y sus puntos de soldadura (PADS). A estos íconos se les agregan los siguientes:

PAD: Sirve para ubicar las islas para la soldadura de los terminales de los componentes. Al activar ésta función aparece en el lado superior de la pantalla un menú donde se puede elegir la forma de la isla, su diámetro y el diámetro del agujero correspondiente (Drill).

<u>NOTA</u>: El mismo ícono que en el módulo de diseño de circuito impreso activaba la función VIA (isla), acá activa la función PAD. La diferencia entre "PAD" y "VIA" es que éste último no permite definir una conexión con la función SIGNAL.



SMD PAD: Idem anterior pero para componentes de montaje superficial

Cuando se accede a la edición del dispositivo, aparecen del lado izquierdo de la pantalla, además de algunas herramientas ya vistas, los siguientes íconos:

PREFIX: Sirve para definir el prefijo del nombre que le asignará el programa a este dispositivo cuando sea utilizado (por ejemplo "IC" para los integrados, "R" para las resistencias, etc.).



PACKAGE: Asigna un encapsulado a los símbolos que estén presentes en la pantalla (incorporados a ésta con "ADD") y que van a formar parte del dispositivo que deseamos generar. De esta manera se pueden incorporar más de un símbolo en un solo encapsulado (por ejemplo para integrados de compuertas, o arrays de transistores).



CONNECT: Permite asignarle a cada terminal de los símbolos un PAD del encapsulado.

| Connect | | | | × |
|---|---|-----|--------------|-----------|
| Pin | Pad | Cgr | nection | |
| A. I0 A. I1 A.O B. I0 B. I1 B.O C. I0 C. I0 C. I1 C.O D. I0 D. I1 D.O P.GND F VCC | × 1 23 45 67 89 10 111 122 13 | * | | × |
| <u> </u> | 2 | 2 | | <u>e</u> |
| | ⊑onnect | | isconnect Io | ggle view |
| | | OK. | Cancel | Help |

Contenido de las librerías

| Librería | Pack | Dev | Contenido |
|----------|------|-----|--------------------------------------|
| 19тысн | 20 | 23 | Furocards with VG connectors |
| 40XX | 3 | 73 | CMOS 40xx-Series CMOS Logic, |
| 40XXSMD | 3 | 72 | Same as above, but with SMD packages |
| 41XX | 1 | 7 | CMOS 41xx-Series CMOS Logic, |
| 41XXSMD | 1 | 7 | Same as above, but with SMD packages |
| 45XX | 4 | 59 | CMOS 45xx-Series CMOS Logic, |
| 45XXSMD | 4 | 59 | Same as above, but with SMD packages |

| 74XX | 11 | 342 | TTL 74xx-Series TTL Logic, |
|-----------|------------------|-----|---|
| 74XXSMD | 8 | 342 | Same as above, but with SMD packages |
| 751XX | 3 | 11 | TTL 75xx-Series TTL Logic, |
| 751XXSMD | 3 | 11 | Same as above, but with SMD packages |
| ACL | 8 | 72 | Texas Inst. ACL Logic, |
| BATTERY | 38 | 51 | Lithium batteries, NC accumulators |
| BURR | 53 | 318 | Burr-Brown components |
| BUSBAR | 18 | 18 | Schroff bus bars |
| BUZZER | 33 | 33 | Buzzers, SMD |
| CAP | 56 | 33 | Capacitors |
| CAP-FE | 25 | 24 | Interference suppression capacitors |
| CAP-TANT | 38 | 38 | Tantal capacitors |
| CAP-WI | 50 | 49 | Capacitors from WIMA |
| CON-DIL | 10 | 20 | DIL connectors for ribbon cables |
| CON-LSTA | 46 | 47 | Pinhead connectors, female |
| CON-LSTB | 39 | 40 | Pinhead connectors, male |
| CON-ML | 21 | 36 | MI, connectors |
| CON-MSF | 16 | 16 | MSE connectors grid 2 5mm |
| CON-MT | 40 | 38 | MT connectors from AMP |
| CON-MT6 | 12 | 12 | MTE crimp connectors from AMP |
| CON_RIB | 15 | 15 | Pibbon cables 2 8 / 4 8 / 6 3mm |
| CON_VC | 21 | 35 | VC connectors from HAPTINC |
| CONNETMM | 2 I Q | 30 | CIMM connectors from AMD |
| CONDUTOR | 20 | 50 | Quick connectors from MD |
| CONQUICK | 50 6 | 00 | DG DG genuerterg |
| DC-DC | 10 | 1 / | De-De converters |
| DEMO | 10 20 | 14 | Dello Ilpiary |
| DIL | 3 <u>4</u> 22 | 0 | DIL packages, Octagon 65 MII/drill 52 MII |
| DIL-E | 32 | 0 | DIL packages, YLongUCt |
| DILSWISCH | 120 | 83 | Did switches, encoder switches |
| DIODE | 138 | 153 | Diodes |
| DISCRETE | 44 | 66 | Discrete components (R,C) |
| DISP-HP | 26 | 42 | Display components from HP |
| DISP-LCD | 9 | 9 | LCDS FROM DATA MODUL |
| DRAM | 2 | 10 | DRAMS from Motorola |
| ECL | 3 | 54 | ECL components from Texas Instr. and Motorola |
| EXAR | 3 | 108 | Exar components |
| F.E.L. | 25 | 52 | FETS |
| FIB-HP | 5 | 12 | Fiber optic components, HP |
| FIB-SI | 3 | 4 | Fiber optic components, Siemens |
| F,TE,O | 7 | 15 | FIFO components |
| FRAMES | 0 | 10 | Drawing frames for schematics |
| FUJITSU | 25 | 71 | Fujitsu |
| FUSE | 21 | 21 | Fuses |
| HARRIS | 11 | 43 | Microprocessor products from Harris |
| HEATSINK | 30 | 30 | Heatsinks |
| HIRSCHM | 22 | 22 | Hirschmann diodes; LS, Scart connectors etc. |
| HOLES | 37 | 7 | Assembly holes |
| IC | 50 | 0 | DIL packages, Octagon 55 Mil |
| IDTCMOS | 51 | 300 | IDT products |
| IND-A | 69 | 69 | Inductors, Trafo ETD29 |
| IND-B | 39 | 15 | Ferrite cores, Siemens |
| INTEL | 15 | 72 | Microprocessor products from Intel |
| INTELPLD | 5 | 7 | PLDs from Intel |
| JUMPER | 19 | 18 | Bridges for single layer boards, SMD sold. |
| bridges | | | |
| JUMPS | 21 | 25 | Jumpers and jumper connectors |
| KEY | 30 | 29 | Keys from RAFI and ITT |

| KEYOMRON | 9 | 9 | OMRON keys |
|------------------|--------|-----------|---|
| LED | 27 | 27 | LEDs |
| LINEAR | 20 | 213 | Analog components |
| м68000 | 11 | 18 | 68000 family components |
| MARKS | 18 | 0 | Crop marks, reference marks |
| MAXTM | 23 | 339 | MAXIM components |
| MEMHITCH | 13 | 51 | Hitachi memory components |
| MEMNEC | 10 | 29 | NFC memory components |
| MEMODV | 9 | 50 | Conoria momory componenta |
| | ע ר | 55 | Meterola migroprogoggor producta |
| MOTOROLA | 7 | 51 100 | NDN there is the set |
| NPN | 27 | 100 | NPN transistors |
| OPTO-TRA | 12 | 12 | Optotransistors from Siemens |
| OPTOCPL | 9 | 71 | Opto couplers |
| PAL | 3 | 45 | PALs, Monolithic Memories |
| PHO500 | 5 | 8 | PHOENIX clamp connectors |
| PHO508A | 28 | 20 | PHOENIX clamp connectors |
| PHO508B | 11 | 11 | PHOENIX clamp connectors |
| PHO508C | 9 | 7 | PHOENIX clamp connectors |
| PHO508D | 26 | 21 | PHOENIX clamp connectors |
| PHO508E | 46 | 40 | PHOENIX clamp connectors |
| PIC | 13 | 154 | Microchip PIC controllers |
| PINH-H | 11 | 18 | Pinhead connectors with lever, horizontal |
| PINH-V | 11 | 18 | Pinhead connectors with lever, vertical |
| PINHEAD | 85 | 47 | Pinhead connectors |
| PLCCPACK | 11 | 0 | PLCC packages |
| DND | 27 | 58 | DND transistors |
| DOLCAD | 56 | 56 | Polarized capacitors |
| | 10 | 11 | PUTALIZED CAPACITOIS |
| PIC-NIC | 10 | 11 | PICS and NICS |
| PTR500 | 33 | 33 | PTR clamp connectors |
| QUARTZ | 25 | 27 | Quartzes, generators, SMD |
| R | 40 | 27 | Resistors |
| R-DIL | 2 | 8 | Resistor networks, DIL |
| R-PWR | 32 | 33 | Power resistors |
| R-SIL | 11 | 45 | Resistor networks, SIL |
| RECTIF | 33 | 33 | Rectifier bridges |
| RELAIS | 47 | 43 | Relais |
| RIBCON | 20 | 20 | PC board connectors |
| RIBCON4 | 6 | 6 | 4-row pc board connectors |
| SIEMENS | 28 | 45 | Siemens components |
| SMD | 26 | 0 | SMD packages |
| SMD-IC | 76 | 0 | SMD packages |
| SMD-SPC | 27 | 0 | SMD packages |
| SOLPAD | 16 | 16 | Soldering pads |
| SPECTAL | 74 | 26 | Special devices, transformer, fuse, lamp, etc |
| SRAM | 6 | 21 | Static RAMs from Motorola |
| SILAN SILBD_A | 30 | 64 | Sub-D connectors 9 to 37 ping |
| | 0 | 0 - | Sub D connectors, 5 to 37 pins |
| | 0 | 0 | Sub-D connectors, 50 prins |
| SUPPLYI | 0 | 14 | Supply symbols |
| SUPPLYZ | 0 | 44 | Supply symbols |
| SWITCH | 22 | 20 | Rotary switches, toggle switches |
| TESTPAD | 12 | 12 | Test areas, test pins |
| TRAFO-B | 47 | 51 | BLOCK transformers |
| TRAFO-E | 25 | 25 | ERA transformers |
| TRAFO-R | 3 | 3 | Ring core transformers |
| TRANS-SM | 64 | 52 | Small power transformers |
| TRANS-PW | 53 | 39 | Power Transformers |
| TRIAC | 32 | 19 | Thyristors, triacs |

| TRIMPOT | 43 | 42 | Trimmpots |
|---------|----|----|------------------------------------|
| ULN | 2 | 24 | ULN ICs |
| V-REG | 36 | 23 | Voltage regulators |
| VARIST | 78 | 78 | Siemens varistors |
| WAGO500 | 11 | 11 | WAGO clamp connectors, grid 5.00mm |
| WAGO508 | 17 | 16 | WAGO clamp connectors, grid 5.08mm |
| WIREPAD | 19 | 15 | Pads for connecting wires |
| WSIPSD | 8 | 83 | WSI components |
| ZILOG | 2 | 7 | Zilog components |
| | | | |

Detalle de la librería "DISCRETE"

| CAP | Ceramic capacitors |
|----------|--|
| CAPNP | Capacitor No Polarity |
| CAPTRIM | Trim Capacitors |
| CAPUS | U.S. symbol version |
| DIODE | Diodes |
| ELC | Tantalum capacitors or Electrolytic |
| L | Inductor |
| POT | Potentionometers EURO |
| POTUS | Potentionometers U.S. symbol |
| POT-TRIM | Potentionometer for multiple turns, i.e. 20 turn POT |
| RESEU | Resistor EURO symbol |
| RESUS | Resistor U.S. symbol |
| RESVAR | Resistor variable |
| RN | Resistor networks |
| THERM | Thermistors |
| VARIST | Varistors |
| ZDIO | Zener diodes |

La función XPAD.EXE

Este programa puede usarse para cambiar la forma y las dimensiones de las islas de los componentes (PADS) de una librería (*.lbr) o un diseño de plaqueta (*.brd).

Sintaxis:

XPAD options filename

Opciones:

-os old pad shape -od old pad diameter -or old drill diameter -ns new pad shape -nd new pad diameter -nr new drill diameter

Los parámetros "-o..." selecciona los "PADS" a ser modificados. Los parámetros "-n..." determina los nuevos valores de los "PADS" seleccionados.

Todos los valores pueden darse en pulgadas (x ej. 0.05in) o en milímetros (x ej. 0.8mm). Default: inch.